

超短パルスレーザーによる

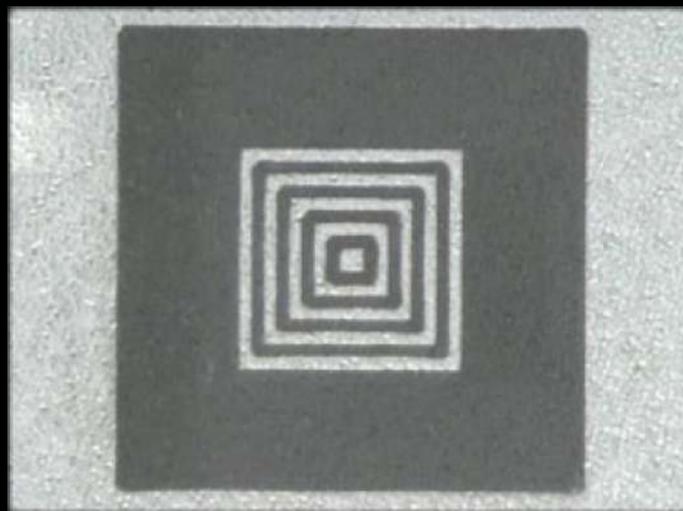
段彫り・パターンニング加工

- 特徴 1 数百ナノ～数ミクロンオーダーで除去深さを制御する事が可能
- 特徴 2 金属、樹脂、ガラス、セラミックス等、全ての材料へ対応可能
- 特徴 3 母材に極力ダメージを与えず、表層膜のみ除去する事が可能

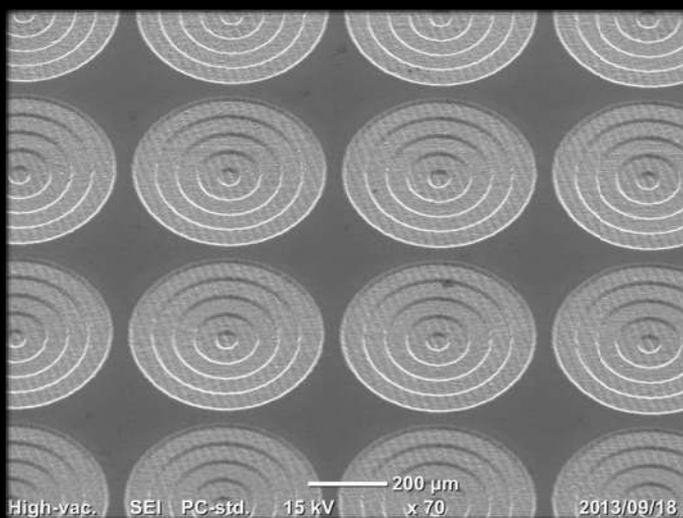
加工事例



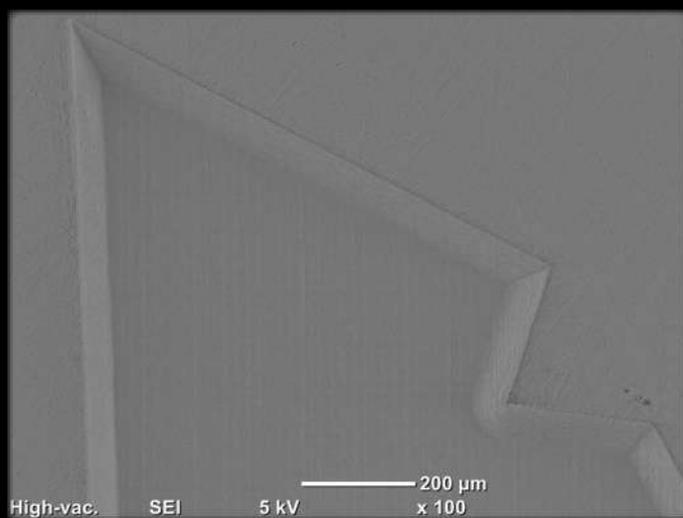
アルミナセラミックスの座繰り加工
深さ：340 μm 板厚：380 μm



PET 上アルミ膜パターンニング加工
膜材質：Al 板厚：500 \AA L/S：40 $\mu\text{m}/40 \mu\text{m}$



アルミへの段彫り加工
直径：各 50,150,250,350,450 μm
深さ：各段 5 μm 全体 25 μm



ジルコニアへの段彫り加工
深さ：160 μm



株式会社リプス・ワークス

〒144-0033 東京都大田区東糀谷 6-4-17 OTA テクノ CORE 409 号室

TEL：03-3745-0330 FAX：03-3745-0331

URL：https://www.lps-works.com E-mail：sales@lps-works.com